

平成 17 年 7 月 19 日

各 位

会 社 名 三 益 半 導 体 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 取 締 役 社 長 中 澤 正 幸
(コード番号 8155 東証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 八 高 達 郎
T E L 0 2 7 - 3 7 2 - 2 0 1 1

第三者割当増資による信越化学工業株式会社との資本提携に関するお知らせ

平成17年7月19日開催の当社取締役会において、信越化学工業株式会社（東証第一部：4063、以下「信越化学工業」）を割当先とする第三者割当による新株式発行（以下「本第三者割当増資」）を決議し、資本提携することといたしましたのでお知らせいたします。

なお、本第三者割当増資払込後、当社の主要株主並びにその他の関係会社の異動が発生する見込みです。

記

・本提携の趣旨及びその内容

半導体市場は世界的な需要の増大に伴い中長期的に拡大していくことが見込まれております。また半導体シリコンウェハー市場も 300mm ウェハーを中心に継続的に伸長するものと予想されます。一方、デバイスの微細化や高精度化に対応するシリコンウェハーの品質特性への要求は急速にその厳しさを増しており、更に設備投資の巨額化・市場における競争の激化など、事業を取り巻く環境は間断なく変化しております。

当社は長年にわたりシリコンウェハー最大手の信越化学工業よりウェハー加工を受託し、高い加工技術に裏づけされた最先端品の加工を得意としてきました。また、当社の独自展開による再生ウェハー事業も含めて 300mm ウェハー加工拠点としての重要性は一層増しております。そうした背景のもとで、QCDS（品質・コスト・納期・サービス）における競争力を飛躍的に強化充実させることが不可欠となってまいりました。

当社は、事業環境の変化に機動的に対応し、確固たる事業基盤を確立して将来にわたる永続的な発展を確実なものとするため、今回、信越化学工業を割当先とする第三者割当増資による資本提携を決定いたしました。

信越化学工業の半導体シリコン事業は世界最大級であります。豊富な資金力と優れた技術開発力、グローバルな営業網から得られる豊富な情報量と将来を見据えた事業戦略など、高い総合力で業界をリードし、トップメーカーとしてのゆるぎない地位を確立しています。

なお当社は、本提携により以下の諸点を推進してまいります。

最先端加工技術の共同開発による最適技術の確立

技術交流促進による品質・技術の向上

連携による相互の投資効率および生産性の向上とコスト低減

同社のマーケティング・情報力とのシナジー効果による再生ウェハー事業の戦略性向上と
シェア拡大
連携によるカスタマーサービスの強化充実と業界におけるプレゼンス向上

・本第三者割当増資における新株式発行要領

- | | |
|---------------|--------------------|
| (1) 発行新株式数 | 普通株式 7,000,000 株 |
| (2) 発行価額 | 1 株につき金 1,530 円 |
| (3) 発行価額の総額 | 10,710,000,000 円 |
| (4) 資本組入額 | 1 株につき金 765 円 |
| (5) 資本組入額の総額 | 5,355,000,000 円 |
| (6) 申込期日 | 平成 17 年 8 月 4 日(木) |
| (7) 払込期日 | 平成 17 年 8 月 4 日(木) |
| (8) 配当起算日 | 平成 17 年 6 月 1 日(水) |
| (9) 割当先及び割当株数 | 信越化学工業 7,000,000 株 |
- (10) 新株発行日から 2 年以内に割当新株式を譲渡する場合には、当社へ報告する旨の確約を得る予定であります。
- (11) 前記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とします。

(注)発行価額の決定方法

当該増資に係る取締役会決議の直前日までの 1 ヶ月(平成 17 年 6 月 16 日から平成 17 年 7 月 15 日まで)の東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値 1,554 円に 98.46%を乗じた額とし、1,530 円と決定いたしました。

【ご参考】

1. 発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数	21,533,779 株(平成 17 年 5 月 31 日現在)
本第三者割当増資による増加株式数	7,000,000 株
本第三者割当増資後の発行済株式総数	28,533,779 株

2. 資金の用途等

(1) 資金の用途

このたびの増資による調達資金は、今後の提携を核とした事業展開におけるシリコンウェハー加工事業の業容拡大等(生産規模の拡大、先端加工技術の開発など)に必要な設備資金並びに運転資金に充当する方針であります。

(2) 業績に与える見通し

上記の設備投資により、生産能力の増強による売上高の伸長、品質等の向上による収益の増加を見込んでおります。

3. 株主への利益配分等

当社は自己資本の充実と株主への利益配分をともに経営の最重要課題と位置付けており、経営基盤強化のために必要な内部留保を確保しつつ、継続的な安定配当を実現していくことを基本方針としております。

なお、平成 17 年 5 月期は前期より 1 株につき 2 円増配し 17 円の配当（配当性向 15.8%、株主資本利益率 8.5%、株主資本配当率 1.3%）を予定しております。

内部留保資金につきましては、経営基盤強化のために必要な内部留保を確保しつつ、成長へ向けて事業拡大のために有効投資いたします。

また、継続的な自己株式の取得により発行済株式数を削減し、1 株当たりの株主価値の向上を図ってまいります。

4. 過去 3 年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等

(1) エクイティ・ファイナンスの状況

発行形態	発行日	発行総額	転換価額	償還日
第 5 回無担保 転換社債型新株 予約権付社債	平成 14 年 9 月 24 日	100 億円	1,418 円	平成 19 年 11 月 30 日

(2) 過去 3 決算期間及び直前の株価等の推移

	平成 15 年 5 月期	平成 16 年 5 月期	平成 17 年 5 月期	平成 18 年 5 月期
始値（円）	1,675	1,289	1,610	1,600
高値（円）	1,710	1,801	1,729	1,630
安値（円）	1,000	1,275	1,317	1,490
終値（円）	1,282	1,625	1,600	1,594
1 株当たり利益(円)	65.48	92.58	107.49	-
株価収益率（倍）	19.58	17.55	14.89	-

(注) 1.平成 18 年 5 月期については、7 月 15 日現在で表示しております。

2.株価収益率は、決算期末の株価（終値）を当該決算期末の 1 株当たり当期純利益で除した数値であります。

5. 割当先の概要

割当先の名称	信越化学工業株式会社		
割当株数	7,000,000 株		
払込金額	10,710 百万円		
割当先の内容	本社所在地	東京都千代田区大手町二丁目 6 番 1 号	
	代表者の氏名	代表取締役社長 金川 千尋	
	資本の額	117,513 百万円	
	発行済株式総数	430,118 千株	

	主な事業内容	合成樹脂並びに無機及び有機工業製品、電子材料及び磁性材料の製造及び販売			
	大株主及び 持株比率	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)		9.77%	
		日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)		8.82%	
		日本生命保険相互会社		5.29%	
	主な経営成績 及び財政状態 (連結)	(百万円)	平成 16 年 3 月期	平成 17 年 3 月期	
		売上高	832,804	967,486	
		営業利益	125,625	151,734	
		経常利益	125,612	151,503	
		当期純利益	74,805	93,160	
		総資産	1,386,216	1,476,248	
株主資本		900,724	996,307		
当 社 と の 関 係	出資関係	当社普通株式 1,093 千株(うち、間接保有分 359 千株)を保有しております。			
	取引関係等	半導体シリコンウェハー加工を当社に発注しております。			
	設備の貸借関係	該当事項はありません。			
	役員の兼務関係	該当事項はありません。			

(注)「割当先の内容」は平成 17 年 3 月 31 日現在、「当社との関係」は平成 17 年 5 月 31 日現在におけるものであります。

6. 本第三者割当増資後の大株主構成等

順位	株主名	所有株式数 (千株)	所有割合 (%)
1	信越化学工業株式会社	7,733	27.10
2	中澤 正幸	2,159	7.57
3	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	1,876	6.57
4	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	1,263	4.43
5	有限会社なかざわ	1,151	4.03

(注)所有株式数及び所有割合は、平成 17 年 5 月 31 日現在の株主名簿を基準として作成しております。

以 上